

REIVINDICACIONES

1. Un método para generar una secuencia de planos de corte para cortar una secuencia P de piezas de vidrio en una secuencia F de láminas de vidrio, estando dichas piezas de vidrio
5 destinadas a ser apiladas de acuerdo con los requisitos de orden y/o posicionamiento en uno o más soportes C_k , comprendiendo dicho método los siguientes pasos:
 - a. la recuperación de información en relación con la ubicación y la naturaleza de las fallas en cada una de las láminas de vidrio de la secuencia F ;
 - b. la definición de un criterio de optimización σ ;
 - 10 c. la generación, implementada por computadora, de una o más secuencias S_i de los planos de corte PD_{ij} para las láminas de vidrio de acuerdo con la ubicación de las fallas en cada una de las láminas de vidrio y mientras se cumplen los requisitos de orden y/o posicionamiento de las piezas de vidrio para cada soporte C_k ;
 - d. la selección, implementada por computadora, de una de las secuencias S_i de los
15 planos de corte PD_{ij} de acuerdo con el criterio de optimización σ .
2. El método para generar una secuencia de planos de corte según lo reivindicado en la reivindicación 1, de modo tal que el criterio de optimización σ se elige entre un criterio de pérdida de área de superficie total mínima o un criterio de corte mínimo de láminas de vidrio.
3. El método para generar una secuencia de planos de corte según lo reivindicado en
20 cualquiera de la reivindicación 1 o reivindicación 2, de modo tal que los requisitos de orden y/o posicionamiento se eligen entre la orientación de las piezas de vidrio en cada soporte C_k y/o el orden de las piezas de vidrio en cada soporte C_k .
4. El método para generar una secuencia de planos de corte según lo reivindicado en una de las reivindicaciones 1 a 3, de modo tal que los planos de corte comprenden varios niveles
25 jerárquicos de corte.
5. El método para generar una secuencia de planos de corte según lo reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, de modo tal que la generación de la secuencia o secuencias S_i de los planos de corte PD_{ij} para las láminas de vidrio se lleva a cabo de modo tal que las piezas de vidrio a cortar contienen fallas que cumplen con un criterio de severidad Ψ
30 definido de antemano.
6. El método para generar una secuencia de planos de corte según lo reivindicado en la reivindicación 5, de modo tal que el criterio de severidad Ψ se elige de entre un criterio de tamaño de falla, un criterio de densidad de falla en la lámina de vidrio, un criterio de naturaleza de falla o un criterio de alteración óptica, solo o en combinación.
- 35 7. El método para generar una secuencia de planos de corte según lo reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, de modo tal que la generación de secuencias S_i de los planos de corte PD_{ij} del paso (c) y/o la selección de una de las secuencias S_i de los planos de corte PD_{ij} del paso (d) se llevan a cabo con la ayuda de un dendrograma exploratorio, un método de búsqueda heurística o metaheurística, la optimización lineal por la dualidad de Lagrange o la programación dinámica.
- 40 8. El método para generar una secuencia de planos de corte según lo reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, de modo tal que la duración requerida para ejecutar el paso para generar la secuencia o secuencias S_i de los planos de corte PD_{ij} para las láminas de vidrio no exceda una duración predefinida.

9. El método para generar una secuencia de planos de corte según lo reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, de modo tal que la recuperación de información del paso (a) comprende la lectura, con la ayuda de un medio de adquisición, de un símbolo que forma un código que puede leerse a través de la cara de borde de cada una de las láminas de vidrio, conteniendo dicho código un identificador asociado con la información relacionada con la ubicación y la naturaleza de las fallas en la lámina de vidrio.
10. El método para generar una secuencia de planos de corte según lo reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 9, de modo tal que dicho identificador está contenido en una base de datos que contiene la información relacionada con la ubicación y la naturaleza de las fallas en la lámina de vidrio.
11. El método para generar una secuencia de planos de corte según lo reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, de modo tal que los pasos (a), (b) y (c) se implementan de acuerdo con un modelo de computación en la nube.
12. Un método de corte que comprende un método para generar una secuencia de planos de corte según lo reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11, luego un paso (e) para cortar piezas de vidrio en las láminas de vidrio de acuerdo con la secuencia S_i de los planos de corte PD_{ij} que se selecciona en el paso (d) de dicho método de generación.
13. Un programa informático que comprende instrucciones para la ejecución de los pasos del método para generar una secuencia de planos de corte según lo reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11.
14. Un medio de almacenamiento legible por computadora en el que está grabado un programa informático que comprende instrucciones para ejecutar los pasos del método para generar una secuencia de planos de corte según lo reivindicado en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11.
15. Un dispositivo para generar una secuencia de planos de corte para cortar una secuencia P de piezas de vidrio en una secuencia F de láminas de vidrio, estando cada una de las piezas de vidrio destinada a ser apilada de acuerdo con requisitos de orden y/o posicionamiento en uno o más soportes C_k , comprendiendo dicho dispositivo los siguientes módulos:
- un módulo para recuperar información en relación con la ubicación y la naturaleza de las fallas en cada una de las láminas de vidrio de la secuencia F ;
 - un módulo para definir un criterio de optimización σ ;
 - un módulo para generar una o más secuencias S_i de los planos de corte PD_{ij} para las láminas de vidrio de acuerdo con la ubicación de fallas en cada una de las láminas de vidrio y cumplir con los requisitos de orden y/o posicionamiento de las piezas de vidrio para cada soporte C_k ;
 - un módulo para seleccionar una de las secuencias S_i de los planos de corte PD_{ij} de acuerdo con el criterio de optimización σ .
16. El dispositivo para generar una secuencia de planos de corte según lo reivindicado en la reivindicación 15, de modo tal que el módulo para recuperar información relacionada con la ubicación de fallas en cada una de las láminas de vidrio de la secuencia F es un módulo para leer un símbolo que forma un código que se puede leer a través de la cara de borde de cada una de las láminas de vidrio, conteniendo dicho código un identificador asociado con la información relacionada con la ubicación y la naturaleza de las fallas en la lámina de vidrio.
17. El dispositivo para generar una secuencia de planos de corte según lo reivindicado en la reivindicación 16, de modo tal que comprende además un módulo para telecomunicaciones directas o indirectas con un medio de almacenamiento legible por computadora que contiene

una base de datos que contiene, para cada identificador, la información relacionada con la ubicación de fallas en cada lámina de vidrio de la secuencia F .

18. Un dispositivo de corte que comprende un dispositivo para generar una secuencia de planos de corte según lo reivindicado en una de las reivindicaciones 15 a 17, y un módulo para
5 cortar piezas de vidrio en las láminas de vidrio de acuerdo con la secuencia seleccionada S_i de